

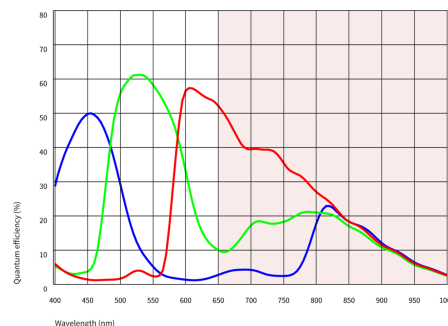
■ 量産中
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	グローバルシャッター
特性	リニア
解像度/ピクセル	2 MP
有効画素数	2.35 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	1936 x 1216 ピクセル
アスペクト比	16:10
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/2.3"
撮像面積	6.679 mm x 4.195 mm
光学センサーの対角	7.89 mm 1/2.3"
画素サイズ	3.45 μm
CRA (主光線角)	0 °
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX392LQR-C
ゲイン (マスター/RGB)	16x/16x
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	256 / 2
AOI 画像の高さ、ステップ幅	2 / 2
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	2 / 2
ピンニング水平	-
ピンニング垂直	-
ピンニング手法	水平: 加算 / 垂直: 加算
ピンニング係数	-
デシメーション(サブサンプリング) 水平	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング) 垂直	増加したフレームレート
デシメーション(サブサンプリング) 手法	M/C 自動
デシメーション(サブサンプリング) 係数	2x2



モデル

フレームレートフリーランモード	53 fps
フレームレートトリガー（連続）	53 fps
フレームレートトリガー（最大）	75 fps
露出時間（最小～最大）	0.025 ms - 2000 ms
長時間露出（最大）	30000 ms
ラインレート・トリガーモード（ラインスキャン）	3067 1/s
1フレームあたりのライン数（ラインスキャン）	8000
消費電力	1.5 W - 3.7 W
画像メモリ	128 MB

HDR

モード	Sequencer
-----	-----------

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

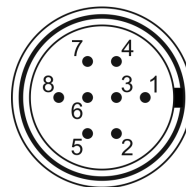
動作時の許容デバイス温度	0 ° C - 55 ° C / 32 ° F - 131 ° F
保管時の許容周囲温度	-20 ° C - 60 ° C / -4 ° F - 140 ° F
湿度（相対湿度、結露なし）	20 % - 80 %

コネクター

インターフェースコネクター	GigE RJ45、ねじ止め式
I/O コネクター	ヒロセ製 8 ピンコネクター（HR25-7TR-8PA(73)）
電源	12 V ~ 24 V または PoE

ピン割り当て I/O コネクター

1	接地（GND）
2	オプトカブラありのフラッシュ出力（-） - Line 1
3	汎用入出力（GPIO）1 - Line 2
4	オプトカブラありのトリガー入力（-） - Line 0
5	オプトカブラありのフラッシュ出力（+） - Line 1
6	汎用入出力（GPIO）2 - Line 3
7	オプトカブラありのトリガー入力（+） - Line 0
8	入力電源（VCC）、12 ~ 24 V DC



設計

レンズマウント	C-マウントレンズ
保護構造	IP30
外形寸法	34.0 mm x 44.0 mm x 47.0 mm
重量	105 g
ハウジング素材	アルミニウム

Features

オンカメラ画像前処理機能のリスト。

このテーブルのすべての機能は、ホストコンピュータ上で画像の前処理を行うための IDS peak ソフトウェアを介して利用可能です（センサーのモデルによって異なります）。

画像取得	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	✓
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	✓
フラッシュ	Flashing	✓
	PWM flashing	✓
画像調整	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	✓
	Color correction	✓
	Gamma	✓
	LUT	✓
	Mirror/flip	X/Y
統合画像処理	Pixel formats	
	Mono8	
	BayerRG8	
	BayerRG10	
	BayerRG10p	
	BayerRG12	
	BayerRG12p	
統合画像処理	BGR8	
	RGB8	
	BGR10p32	
	RGB10p32	
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	2x2
統合画像処理	Binning (FPGA)	✓
	Binning (Sensor)	
その他	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	✓
	Sequencer	✓
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	2. 10